

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：

- 1、公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年；
- 2、公司向交通银行股份有限公司海淀支行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年；
- 3、公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度，授信期限 5 年；

上述授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

因公司本年度累计授信总额（含本次）将达到公司最近一期经审计总资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则规定，本议案尚

需提交股东大会审议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2018年10月29日